

DEKPIR FLOOR U

DEK

TEPELNÁ IZOLACE Z TUHÉ POLYISOKYANURÁTOVÉ PĚNY (PIR)

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

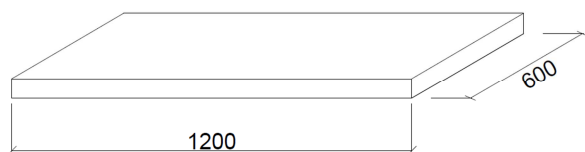
DEKPIR FLOOR U je tepelná izolace na bázi polyisokyanurátu. Materiál je díky svým tepelněizolačním a mechanickým vlastnostem, dobré zpracovatelnosti a dalším parametrům vhodný pro vytvoření zatížené tepelněizolační vrstvy podlahových konstrukcí. Tepelněizolační desky DEKPIR FLOOR U se skládají z jádra a z povrchové úpravy provedené na obou stranách desky. Jádro desky je tvořené tuhou polyisokyanurátovou pěnou. Povrchová úprava je ze sendvičové fólie (papírová vložka s oboustranným hliníkovým potahem). Povrchová úprava je adhezivně spojená s jádrem během vypěňování.

VÝROBA

Výroba materiálu spočívá v nanášení napěňující směsi polyisokyanurátu mezi dva pásy povrchové fólie. Vypěněním a vytvrdnutím materiálu vzniká ve výrobní lince pás materiálu, který se dělí na potřebný formát tepelněizolačních desek.

STANDARDNÍ TVAR A ROZMĚRY

Tepelněizolační desky DEKPIR FLOOR U se vyrábí v rozměru 1 200×600 mm (případně ve formátu 2 400×1200 mm) a v tloušťkách 30, 40, 50, 60, 70, 80 a 100 mm. Desky mají rovnou hranu.



POUŽITÍ

Desky DEKPIR FLOOR U jsou určeny pro vytvoření zatížené tepelněizolační vrstvy podlah obytných, společenských, obchodních a

administrativních ploch dle ČSN EN 1991-1-1. Výrobek lze použít jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Tepelněizolační desky DEKPIR FLOOR U jsou vhodné zejména pro následující aplikace:

- tepelná izolace podlah s roznášecí vrstvou z vyztuženého betonu,
- tepelná izolace podlah s roznášecí vrstvou tvořenou litým potěrem na bázi síranu vápenatého (anhydrit),
- tepelná izolace podlah s roznášecí vrstvou z podlahových konstrukčních desek,
- tepelná izolace podlah s podlahovým vytápěním (v kombinaci se systémovými deskami podlahového vytápění, např. DEKPERIMETER PV-NR75).

Desky DEKPIR FLOOR U neplní funkci kročejové izolace.

APLIKACE

Desky se kladou na suchý a vyrovnaný podklad. Mezní odchylka místní rovinnosti podkladu má být stanovena projektem (v souladu s ČSN 74 4505) tak, aby bylo při realizaci následujících vrstev reálné dosáhnout požadované rovinnosti finálního povrchu podlahy. Vyrovnání nerovností podkladu lze provést kladením tepelněizolačních desek do stavebního lepidla nanášeného zubovým hladítkem. Proto doporučujeme kladení desek na podklad s mezní odchylkou rovinnosti max. 2 mm na 2 m lati. Lepidlo, s minimálním množstvím záměsové vody, slouží pouze k vyrovnání podkladu a usazení, nikoli k připevnění desek. Mírné naleptání a narušení hliníkové fólie není závadou. Větší nerovnosti lze vyrovnat např. podsypem z drceného

keramzitu frakce 0–4 mm v tl. cca 10 mm. Desky se kladou na sraz, se spárami na vazbu. Před prováděním roznášecí desky z betonu nebo z anhydritu je nutné provést separační vrstvu z PE fólie DEKSEPAR. Fólie musí být v přesazích slepená a po obvodu místnosti vytažená na stěny. Při aplikaci roznášecí vrstvy metodou suché výstavby, z podlahových desek, není použití separační fólie nutné.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Desky jsou dodávány v označených balících opatřených polyetylenovou fólií. Obal z polyetylenové fólie není určen pro venkovní skladování desek. Desky musí být chráněny proti srážkám, vzdušné vlhkosti a přímému slunečnímu záření. Desky nesmí ležet přímo na zemi. Krátkodobě lze desky skladovat venku, pouze pokud jsou zakryty nepromokavou

plachtou nepropouštějící UV záření.

ODOLNOST PROTI ROZPOUŠTĚDLŮM

Tepelná izolace je krátkodobě odolná kontaktu s benzínem a s většinou zředěných kyselin, zásad a minerálních olejů. Dlouhodobé působení těchto látek je třeba vyloučit. Tepelná izolace není odolná některým dalším organickým rozpouštědlům. Lepidla obsahující methylethylketon ji poškozují.

Vhodnou separací musí být zabráněno přímému styku povrchové fólie tepelněizolačních desek s anhydritovou směsí.

Tepelná izolace a povrchová úprava použitá při výrobě je odolná proti plísním a není zdrojem potravy pro hmyz.

TABULKA 01 | VOLBA TLOUŠTKY TEPELNÉ IZOLACE DEKPIR FLOOR U

	Požadované $U_{N,rq}$	Doporučené $U_{N,rc}$
hodnoty součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2 ¹⁾	0,45 (W/m ² .K)	0,30 (W/m ² .K)
tloušťka tepelné izolace DEKPIR FLOOR U pro splnění požadovaných a doporučených hodnot	50 mm ($U=0,39$ (W/m ² .K))	70 mm ($U=0,29$ (W/m ² .K))
tloušťka tepelné izolace z EPS 100 (dle ČSN 73 0540-3) pro splnění požadovaných a doporučených hodnot	80 mm ($U=0,39$ (W/m ² .K))	110 mm ($U=0,30$ (W/m ² .K))

1) Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro podlahy oddělující prostor s návrhovou vnitřní teplotou 20 °C a zeminu dle ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

TABULKA 02 | TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU

Označení výrobku			DEKPIR FLOOR U		
Parametry dle ČSN EN 13165			Třída/Úroveň	Hodnota	Jednotka
tolerance tloušťky	jmenovitá tloušťka	< 50 mm	T2	± 2	mm
		50 až 75 mm		± 3	
		> 75 mm		+ 5, - 3	
rozměrová stabilita za určených podmínek teploty a vlhkosti	relativní změny	délky $\Delta \epsilon_l$	DS(70,90)3	≤ 2	%
		šířky $\Delta \epsilon_b$		≤ 2	
		tloušťky $\Delta \epsilon_d$		≤ 6	
	relativní změny	délky $\Delta \epsilon_l$	DS(-20,-)1	≤ 1	%
		šířky $\Delta \epsilon_b$		≤ 1	
		tloušťky $\Delta \epsilon_d$		≤ 2	
pevnost v tlaku při 10% stlačení			CS(10\Y)150	≥ 150	kPa
pevnost v tahu kolmo k rovině desky			TR80	≥ 80	kPa
deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λ_D			0,022		W.m ⁻¹ .K ⁻¹
tepelný odpor	jmenovitá tloušťka	d _N 30 mm	1,35	m ² .K.W ⁻¹	
		d _N 40 mm	1,80		
		d _N 50 mm	2,25		
		d _N 60 mm	2,70		
		d _N 70 mm	3,15		
		d _N 80 mm	3,60		
		d _N 100 mm	4,50		
Další parametry					
třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1			E		-
objemová hmotnost			32 (± 3)		kg.m ³
faktor difuzního odporu μ tepelně izolačního jádra dle ČSN EN ISO 10456:2009			60		-

TECHNICKÝ LIST TL-DEK-0283